

微纳切割晶圆盐晶片超薄硅晶圆片激光微孔划片开槽任意切

产品名称	微纳切割晶圆盐晶片超薄硅晶圆片激光微孔划片开槽任意切
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

微纳切割晶圆盐晶片超薄硅晶圆片激光微孔划片开槽，来图个性定制任意切。晶圆是指制作硅半导体电路所用的硅晶片，其原始材料是硅。高纯度的多晶硅溶解后掺入硅晶体晶种，然后慢慢拉出，形成圆柱形的单晶硅。硅晶棒在经过研磨，抛光，切片后，形成硅晶圆片，也就是晶圆。国内晶圆生产线以8英寸和12英寸为主。

晶圆的主要加工方式为片加工和批加工，即同时加工1片或多片晶圆。随着半导体特征尺寸越来越小，加工及测量设备越来越先进，使得晶圆加工出现了新的数据特点。同时，特征尺寸的减小，使得晶圆加工时，空气中的颗粒数对晶圆加工后质量及可靠性的影响增大，而随着洁净的提高，颗粒数也出现了新的数据特点。

华诺激光公司是一家以激光切割、激光打孔、激光焊接、激光打标刻字的为主的，立足北京，为您服务，联系刘经理，我们将竭诚为您服务！